



## Le mot du Président

L'IMAPS France a tenu son assemblée générale le 21 septembre ; tous nos adhérents ont reçu le compte rendu de cette assemblée. Malgré tout, je souhaite éclaircir la situation actuelle puisque l'assemblée fournit une synthèse de l'année 2016 et l'adoption des résolutions pour l'année en cours et 2018. Mais la transition qui s'est déroulée à partir du 11 juillet 2017 a occupé le bureau IMAPS et les co-gérants d'INTERCONEX (Reynald Deroche et Gérald Génin) durant toute la période estivale afin d'être prêt pour aborder ce dernier trimestre 2017. En effet, IMAPS France, l'actionnaire unique, a décidé de réaliser l'absorption d'INTERCONEX en prenant tout l'actif et le passif. Nous n'avions plus le choix face aux difficultés financières que traversait INTERCONEX.

La société INTERCONEX a été créée il y a plus de 20 ans pour réaliser les activités d'organisation d'événementiels pour l'association IMAPS France. Tous les participants à nos événements IMAPS s'inscrivaient via INTERCONEX uniquement. Vous aviez donc en point de contact soit Florence Vireton soit Gérald Génin. Lors des événements, les co-gérants et la salariée d'INTERCONEX vous accueillait et s'occupaient des pauses et du dîner de gala. Ce temps-là est désormais révolu.

La conséquence directe a été d'embaucher Madame Florence Vireton en CDI à l'association dès le mois de septembre 2017 d'une part et d'autre part, d'effectuer le déménagement du siège social vers l'Espace Hamelin à Paris. Ce déménagement est un événement distinct de l'absorption mais il était opportun de le réaliser à une fin d'économie globale. Et au-delà de l'aspect financier, l'Espace Hamelin nous rapproche des syndicats et autres associations du domaine de l'électronique.

Alors en tant qu'adhérent IMAPS France, n'hésitez à venir visiter notre bureau où Florence vous fera un accueil des plus chaleureux.

Je finirai ce mot par mes remerciements aux deux co-gérants d'INTERCONEX qui ont mis en place la structure organisationnelle qui perdure actuellement et dont vous pourrez toujours apprécier l'efficacité au travers des prochains événements et de notre site Internet.

Les membres du bureau et le comité directeur vont s'appuyer sur cette base pour pérenniser l'activité.

**Alexandre VAL**

*"Everything in electronics between the chip and the system" (ISHM – Une définition du Packaging)*

## Editorial,

Chers lecteurs/lectrices, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire à la 5<sup>ème</sup> Edition de l'ATW Medical a Lyon, les 22 et 23 Novembre prochains, cet événement clôturera l'année 2017. Ce sera l'occasion de découvrir les dernières tendances en matière de dispositifs médicaux mais aussi de matériaux et technologies innovants dans le secteur médical. Veuillez d'ores et déjà noter sur vos agendas les deux événements du calendrier 2018, Thermique à La Rochelle, et MinaPad à Grenoble, et plus encore à venir.

**Sanae BOULAY**

## Calendrier IMAPS France 2017/2018

<p>Les 22 et 23 Novembre 2017, Lyon 5<sup>ème</sup> ATW Microelectronics, Systems &amp; Packaging for Medical Applications</p>
<p>Les 31 Janvier et 1<sup>er</sup> Février 2018, La Rochelle 13<sup>ème</sup> ATW Micro Packaging and Thermal Management</p>
<p>Les 16 et 17 Mai 2018, Grenoble 6<sup>ème</sup> Micro/Nano Electronics Packaging &amp; Assembly, Design and Manufacturing Forum</p>

**From Nano to Macro Power Electronics  
and Packaging International Workshop  
11 & 12 October 2017, Tours - France**

**General Chair**

**Stéphane BELLENGER, Éolane Angers**

**Co-Chairs**

**Daniel ALQUIER, Institut GREMAN**

**Christophe SERRE, ST Microelectronics  
Tours**

La 9<sup>ième</sup> édition du Workshop sur les technologies et les applications autour des thématiques de la Puissance et de l'Energie s'est tenue sur deux jours, les 11 et 12 Octobre derniers, et toujours en langue anglaise.

Cet évènement fidélise d'année en année un auditoire, des orateurs et des exposants autour de ces thématiques qui connaissent un regain d'intérêt depuis plus de 7 ans : l'automobile plus électrique (Tout électrique) et ses fonctions connexes pilotées par les normes euro 7 et suivantes dans une volonté d'écodéveloppement au service de la réduction d'émission CO<sub>2</sub>; l'avionique, notamment autour de l'alimentation des cœurs électriques des moteurs pour continuer la cure drastique d'amaigrissement, les applications domotiques à la lisière de l'ultra connectivité (IOT), de la compacité et des besoins d'optimisation énergétique; le marché vaste des applications industrielle ou celui plus spécifique de l'application ferroviaire.

L'auditorium et le hall de l'Institut GREMAN est un très joli site d'accueil au sein de l'école Polytech Tours pour recevoir ce cycle de conférences. Cet espace nous est mis à disposition grâce à l'aide indéfectible du Professeur Daniel Alquier. 12 exposants nous ont présenté leurs métiers, du matériau à l'équipement, du procédé aux services d'assemblage, de test, de fiabilité ou de simulation, et l'auditorium a reçu pas moins de 80 personnes.



L'organisation de cet évènement a de nouveau été maîtrisée grâce à l'IMAPS (Un grand merci à Florence Vireton pour son professionnalisme), à l'institut GREMAN (Merci encore à Daniel, co-chairman de ces journées), à Christophe Serre, co-chairman que je remercie pour son aide aux conférences et au sponsoring. Nous remercions tout particulièrement nos sponsors pour leur soutien financier : Yole, i-Micronews, ST-Microelectronics et EOLANE, dont certains sont au rendez-vous depuis de nombreuses années déjà.

Le programme compilé par le comité technique grâce aux papiers de nos speakers sans qui cet évènement ne pourrait pas exister, été très dense et d'une qualité très appréciable selon l'avis des auditeurs interviewés.

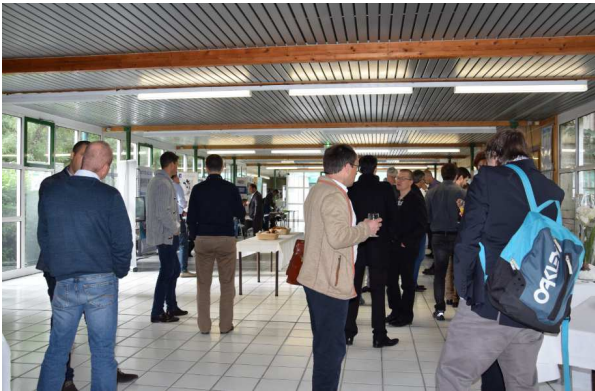
Les papiers de la journée dédiée au programme SAM3 ont ouvert les conférences la journée du 11 octobre, autour des thématiques travaillées par les partenaires de ce projet subventionné européen : les moyens d'analyse de construction et de défaillance des modules de puissance complexes telle que la localisation et la caractérisation de défaillances types : Court-circuit, surconsommation ou encore délaminations dans des modules 3D multicouche complexes. Cette première journée s'est déroulée autour de 6 papiers pour un programme concocté par le GREMAN et ST-Microelectronics (Un merci particulier à Nicolas Vivet de STM), comprenant notamment une introduction à leur programme collaboratif et des présentations d'INFINEON, de PREDICTIVE IMAGE, du FWMH-CAM, de Sector Technology, et du Tescan d'Orsay Physics.

Les dernières technologies pour localiser les zones de délamination présentent l'intérêt évident d'éliminer l'interprétation des images numériques issues des réflexions acoustiques, surtout dans les modules 3D complexes.



La deuxième journée a commencé par un keynote du professeur Guo-Quan Lu de VirginiaTech (USA) sur la technologie additive (Impression 3D et alternatives) pour la réalisation d'inductances de puissance. Une technologie en cours de recherche et développement qui paraît avoir un grand intérêt pour garantir les caractéristiques et performances magnétiques des modules de puissance à très haute fréquence d'application.

Une série de 3 papiers centrés sur les procédés et technologie de report de composants de puissance par frittage argent, que ce soit en application sans pression et basse température (260°C), ou en conditions de pression à plus forte température (300°C) et des intérêts et inconvénients sur les structures et la fiabilité à terme. Un premier papier de ST-Microelectronics, suivi d'un papier de ASE Europe (Et de notre président IMAPS) puis un papier de Composite Innovation pour clôturer ce cycle sur le frittage Argent. Une belle mise à jour de ces capacités à aujourd'hui.



L'après-midi a démarré avec un deuxième keynote présenté par Rolf Aschenbrenner du Fraunhofer Institute de Berlin, sur le packaging en groupe (Panel) de modules de puissance, qui se présente comme une rupture dans l'écosystème du métier du packaging de puces de puissance et celui du monde de la carte (PCB). Une brèche de plus dans la logique souveraine d'une verticalité de la fabrication des modules électroniques pour les applications de la puissance.

Deux autres papiers ont été présentés à la suite du keynote : un développement de procédé de

sérigraphie fine-pitch pour les applications de flip-chip de puces de puissance par le CEA-Leti, et une présentation par l'institut Fraunhofer de Nuremberg dédiée à la récupération d'énergie et aux modules autonomes de mesure de rejets dans les eaux usées ménagères ou industrielles, modules immergés en milieu extrêmement agressif.

Le hall du GREMAN reste toujours très apprécié aux moments des pauses et des buffets, permettant de circuler et d'échanger avec nos exposants.



Durant la soirée du 11 Octobre, un groupe de 50 orateurs, auditeurs et exposants ont pu continuer les échanges dans un cadre plus festif, autour d'un repas au centre de la ville de Tours. Discussions techniques, bonne humeur, vins et plats se sont échangés sur les quatre grandes tables de l'étage qui nous a été réservé. Des discussions d'amélioration des conférences se sont poursuivies dans la soirée avec d'excellentes propositions que nous étudierons cette année pour continuer de faire grandir cet évènement.

Merci infiniment aux orateurs, aux exposants, aux auditeurs et aux organisateurs pour leurs efforts bénévoles à faire que ces conférences puissent présenter chaque année un programme qui étonne et questionne, intéresse nos ingénieurs, chercheurs et industriels, défi toujours présent dans nos mondes technologiques. A l'année prochaine !



*Stéphane Bellenger*

# 5<sup>th</sup> ATW on Microelectronics, Systems and Packaging for Medical Applications

22<sup>nd</sup> – 23<sup>rd</sup> November 2017

Lyon, France

General Chair

Alexandre VAL

ASE Europe, Belgique

L'édition 2017 de la conférence ATW MEDICAL aura lieu les 22 et 23 Novembre à Lyon. La conférence accueillera une vingtaine d'intervenants venus du monde entier. Les technologies d'intégration et d'interconnexions, des applications seront abordés ainsi qu'une session posters dédiée aux étudiants de l'INP Grenoble.

Nous avons réussi à équilibrer nos sessions Applications et Technologies ; les thèmes de la bio compatibilité et des revêtements seront privilégiés cette année. Ainsi que le packaging System In Package avec des propositions techniques pour améliorer la fiabilité et fournir un niveau de pseudo herméticité des modules encapsulés.

La session étudiante donnera la parole à un étudiant de l'ISEP et quatre étudiants de l'INPG ; c'est un moyen d'introduire le corps enseignant dans cet évènement en faisant appel aux écoles et universités, locales en particulier.

Nos deux keynotes présentés ci-dessous ouvriront chacune des deux journées.



**Flex-to-Rigid, the integration platform for the next generation smart catheters.**

**Ronald DEKKER, System in Package Devices, PHILIPS Eindhoven.**



**Advances in integration technologies for miniaturized medical devices**

**Erik JUNG, Business Developer, FRAUNHOFER IZM**



**NOVOTEL LYON GERLAND MUSÉE DES CONFLUENCES**

**70, avenue Leclerc, 69363 Lyon, France**

**Les inscriptions sont ouvertes, nous vous attendons.**

Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir dans cet hôtel localisé à proximité du musée des confluences.

[www.france.imapseurope.org](http://www.france.imapseurope.org) rubrique «MEDICAL 2017».



**5<sup>th</sup> ISSUE**

**13<sup>th</sup> European Advanced Technology  
Workshop on Micropackaging and  
Thermal Management – La Rochelle**  
**Jean-Yves Soulier- Zodiac Aerospace –  
Président de la conférence**

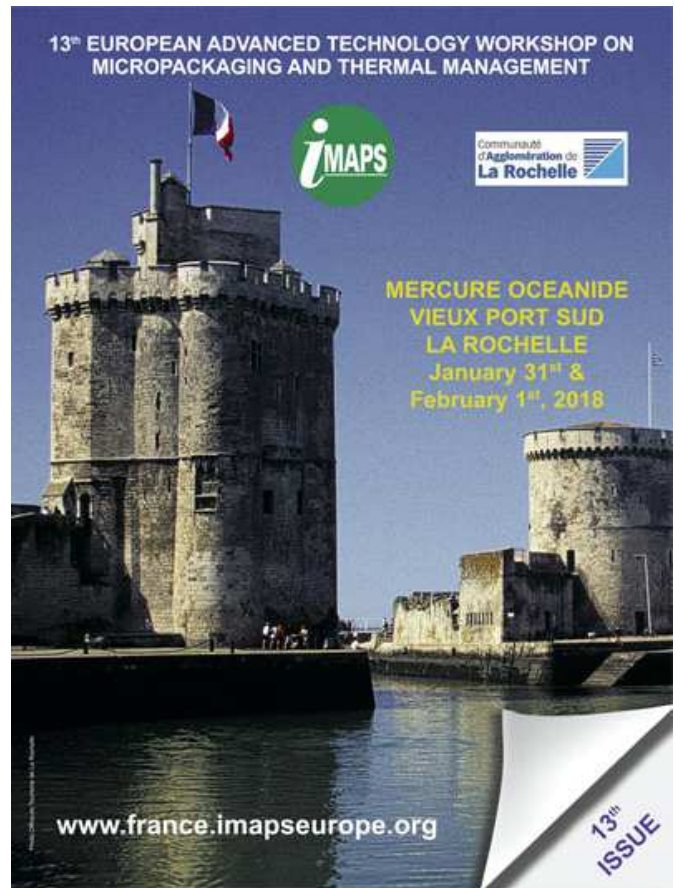
**Comité Technique :**

Jacques FAVRE (aPSI3D)  
Claude SARNO (THALES AVIONICS)  
Thomas HARDER (ECPE)  
Dave SAUMS (DS & A LLC)  
Joel LALLIER, (THALES SYSTEMES  
AEROPORTES)  
Sandrine LELONG-FENEYROU (ZODIAC  
AEROSPACE)  
Isabel OBIETA (TECNALIA)

Au moment où j'écris ces lignes, nous disposons de 19 résumés nous permettant déjà de proposer début décembre un premier programme pour notre prochain workshop qui se tiendra **les 31 janvier et 1<sup>er</sup> février prochains** à La Rochelle. Il reste encore le temps d'intégrer 3 à 4 présentations, qui viendront enrichir des contributions venant d'Allemagne, du Royaume Uni, de Pologne, de France, d'Autriche, des Etats-Unis et d'Espagne, émanant du monde universitaire et de la recherche, de PME et fournisseurs ou d'équipementiers comme Thalès ou MBDA et traitant de méthodes d'essai, de caractérisation des matériaux, de nouvelles technologies dans le domaine des matériaux à changement de phase et dans les systèmes diphasiques, de fiabilité, de modélisation et simulation.

Comme l'an dernier, je formule le vœu que d'ici à la mi-janvier des exemples industriels viennent synthétiser ces travaux en montrant des exemples d'intégration des nouvelles technologies. Les retours d'expérience, heureux ou malheureux (qui n'a pas connu l'échec ?), sont également éligibles au programme des conférences.

Ce workshop est enfin un moment privilégié pour développer nos réseaux industriels et offre un cadre tout aussi privilégié pour faire de la veille technologique. 11 exposants et probablement 6 autres viendront présenter leurs différentes solutions de refroidissement ou outils de test et simulation. Nous donnerons à chacun une tribune de quelques minutes pour promouvoir leurs stands.



6<sup>ème</sup> MiNaPAD 2017

Grenoble, France

Président du Forum  
Jean-Luc DIOT, NovaPack

Responsables techniques  
Michel GARNIER, ST Microelectronics  
Gilles SIMON, CEA LETI

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le sixième forum MiNaPAD (Micro/Nano-Electronics Packaging and Assembly, Design and Manufacturing) aura lieu les 16 et 17 mai 2018 au World Trade Center (au centre de Grenoble, proche de la gare). Nous comptons d'ores et déjà sur votre présence à ce forum international et attendons vos contributions.

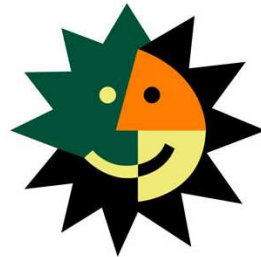
Les thèmes sont détaillés ci-dessous :

- **Advanced Packaging:** 2.5D/3D Packaging, TSV, WLP, FOWLP, Embedded IC Packages, Substrates
- **CAD and tools** for I/O placement for advanced packaging, DfR, opto & RF packages design, thermal & mechanical modeling & simulation
- **Digital deep submicron** technologies for scaling nodes, MEMS, sensors & actuators, RF miniaturization, smart system packaging & heterogeneous integration
- **Innovative packaging** for engineering and growing applications
- **Materials** (adhesives, underfills, molding, dielectrics,...)
- **Emerging technologies** and novel approaches: microfluidics, carbon nano tubes
- **Assembly manufacturing** (BGA, CSP, QFN, SiP, cleaning, coating,...)
- **Reliability**, Wear out, test and characterization, electromigration, thermal management
- **Advanced interconnections:** FlipChip, WLP metallurgies, bumping techniques, non-traditional interconnections, optical connections

Les dates pour la soumission des résumés sont :

- Call for papers deadline is January 26<sup>th</sup> 2018
- Authors will be notified of paper acceptance before March 9<sup>th</sup> 2018

Nous remercions l'engagement et la fidélité de nos deux sponsors :



ASE GROUP

L'appel à communications est ouvert et nous attendons vos contributions. A vos stylos !!!



6<sup>th</sup> Micro/Nano-Electronics Packaging & Assembly, Design and Manufacturing Forum

Conference & Exhibition organized by IMAPS

Email: [imaps.france@imapsfrance.com](mailto:imaps.france@imapsfrance.com). Web: [www.france.imapseurope.org](http://www.france.imapseurope.org)



Call for Papers  
Deadline January 26<sup>th</sup>, 2018

6<sup>th</sup> MiNaPAD Forum 2018

WTC Grenoble, France  
May 16-17, 2018



"Bringing closer Design, Semiconductor, Assembly & Packaging communities"

General chair: Jean-Luc Diot, Technical Chairs: Michel Garnier & Gilles Simon

Abstracts are requested on the following topics (350 words min., one page max):

- Advanced Packaging: 2.5/3D Packaging, TSVs, interposers, wafer level packaging, fan-out WLP, embedded IC packages, substrates (flexible, ceramic, laminate), PCB
  - CAD and tools for I/O placement for advanced packaging, design for reliability, IC and package co-design, opto. & RF package design, thermal & mechanical modeling & simulation
  - Digital deep submicron technologies for scaling nodes, MEMS, sensors, actuators, RF miniaturization, smart system packaging & heterogeneous integration
  - Innovative packaging for emerging and growing applications: photovoltaic, wearable, medical electronics, bio-MEMS, Lab-on-chip power, LEDs, photonics, optoelectronics, etc...
  - Materials (adhesives, underfills, molding, dielectrics...), equipments and processes
  - Emerging technologies and novel approaches: microfluidics, Carbon Nano-Tubes, nanoscale integration
  - Assembly manufacturing (BGA/CSP/QFP/QFN, flux, cleaning, dispensing, coating,...) and business aspects of the industry
  - Reliability, wear out, test and characterization, electromigration, thermal management, power signal integrity
  - Advanced interconnections: flip-chip, interconnections for advanced CMOS process nodes, WLP metallurgies, bumping techniques, non-traditional interconnections, PCB solutions, optical connections
- Your submission must include the mailing address, business telephone number and email address and the content must be without commercial information.  
• Address your abstract to [imaps.france@imapsfrance.com](mailto:imaps.france@imapsfrance.com)  
• Authors will be notified of paper acceptance with instructions for publication before March 9<sup>th</sup>, 2018  
• Authors will be invited to submit a paper for proceedings publication (2 to 6 pages) before April 14<sup>th</sup>, 2018  
• At the discretion of the program committee, submitted abstracts may be considered for poster presentation.  
• Presentations following IMAPS template before April 27<sup>th</sup>, 2018  
• Special student poster session: a poster session for students will address all of the above topics.



## Informations diverses

### IMAPS Europe

Nous souhaitons vous donner quelques informations des autres IMAPS en Europe. Il y a 10 organisations IMAPS actives dont une représentation graphique vous est proposée ci-dessous.



Parmi les adhérents chez nos homologues, on n'est pas surpris de constater que l'Allemagne est en tête avec plus de 280 adhérents. Et vous trouverez les coordonnées des représentants dans chaque pays.

Country	2014	2015	2016	2017	Chapter	Name	Email
France	130	120	112	114	Benelux	Johan De Baets	Johan.DeBaets@UGent.be
Nordic	5-20	10	15		Czech & Slovak	Ivan Szendiuch	szend@feec.vutbr.cz
Germany	280	285	283	282	France	Alexandre Val	Alexandre.Val@aseeu.com
UK	112	146	146	151	France (past president)	Brigitte Braux-Touchat	brigitte.touchat@orange.fr
Italy	27	27	28		Germany	M. Schneider-Ramelow	martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de
Poland	127+8	111	126	126	Germany (ELC treasurer)	Ernst Eggelaar	ee@microtronic.de
Slovenia	120	-	120		Israel (past president)	Uri Barneah	ubarneah@zahav.net.il
Benelux	-	-	38		Italy	Luigi Calligarich	luigi.calligarich@electron-mec.com
CZ	-	30	53		Nordic	Paul Collander	president@imapsnordic.org
Russia	-	22			Poland	Jerzy Potencki	jurpot@prz.edu.pl
					Poland (ELC secretary)	Malgorzata Jakubowska	maljakub@mchtr.pw.edu.pl
					Slovenia	Barbara Malic	barbara.malic@ijs.si; info@midem-drustvo.si
					UK	Chris Hunt	chris.hunt@ceitex.co.uk
					Secretariat	Secretariat	office@imaps.org.uk
					International Ambassador	Nihal Sinnadurai	SINNADURAI@aol.com

Les prochains évènements Européens sont :

- **7<sup>th</sup> Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC) 2018:** September 18 – 21 ; Westin Bellevue Dresden Hotel, Dresden , Germany (ESTC 2018 will be organized by the TU Dresden, the Institute for Electronics Packaging and the Center of Microtechnical Manufacturing)
- **22<sup>nd</sup> European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) 2019:** Pisa (Tuscany), Italy in September 2019 organized by IMAPS-Italy

# Informations diverses

## IFTEC a fêté ses 50ans

L'organisme de formation IFTEC a fêté, cette année, ses 50 ans d'existence et à cette occasion son site a fait peau neuve.

Notre association IMAPS et les organismes de formation professionnels électroniques sont complémentaires afin de maintenir, de développer les connaissances et compétences en France.

<b>50 ans</b> <small>D'EXPERIENCE POUR L'INDUSTRIE</small>	<b>36</b> <small>STAGES</small>	<b>1604</b> <small>STAGIAIRES FORMES EN 2016</small>	<b>1200 m<sup>2</sup></b> <small>DE SALLES ET ATELIERS</small>
---	------------------------------------	---	---

Les quatre activités de l'IFTEC sont :

- Formations IFTEC – 36 stages
- Certifications IPC
- Travaux d'expertise
- Ventes standards IPC

Vous retrouvez le détail de ces activités sur le site : <http://www.iftec.fr>

**IFTEC** INSTITUT

CENTRE DE RESSOURCES ET DE FORMATION  
SUR LES PROCES DE FABRICATION DES CARTES ELECTRONIQUES

ACCUEIL FORMATIONS IFTEC CERTIFICATIONS IPC TRAVAUX D'EXPERTISE VENTE NORMES IPC INFORMATIONS IPC INSCRIPTION

**EXPERIENCE  
QUALITE  
INDEPENDANCE**

La carte électronique est un tout :  
Formations, certifications IPC,  
conseils en conception, circuits  
imprimés, brasage des composants,  
câblage filaire, techniques connexes.  
[EN SAVOIR PLUS](#)



## Informations diverses

### Revue Advancing Microelectronics

En tant que membre IMAPS-France, je vous rappelle que vous avez un libre accès à l'excellente revue Advancing MicroElectronics ; dans cette revue trimestrielle vous trouvez toutes les actualités et des articles techniques sélectionnés au travers des différents évènements américains.

Nous mettons à votre disposition ces documents sur notre site.

En allant sur le site ImapsSource (<http://www.imapsource.org>), vous aurez toutes les archives de cette revue ; n'hésitez pas à vous y inscrire !

#### Editions 2017 disponibles sur notre site :

Janvier/Février 2017

Mars/Avril 2017

#### Les éditions suivantes viennent d'être déposées sur notre site :

Mai/Juin 2017

Juillet/Août 2017



## Note importante projet Européen IMAPS ACADEMY

Nous avons dû modifier notre stratégie quant au montage du projet IMAPS ACADEMY. L'outil de financement européen choisi ne convenait pas aux activités de notre organisation. Nous avons réajusté notre approche afin que le réseau IMAPS et les membres IMAPS puissent tous deux en bénéficier. Il est encore trop tôt pour donner plus de détails. Les ambitions du projet restent inchangées à savoir:

- **Consolider** un réseau d'experts dans le packaging microélectronique en Europe via les différents Chapters IMAPS
- **Former** une nouvelle génération de jeunes chercheurs en développant leur potentiel de créativité, d'esprit d'entreprise et d'innovation.
- **Permettre** aux jeunes chercheurs ainsi qu'aux experts Académiques ou Industriels d'être en contact, à la fois avec les milieux universitaires et industriels afin de compléter le triangle du savoir : formation, innovation et recherche.
- **Offrir** de meilleures perspectives de carrière en ouvrant les horizons de formation, en encourageant la mobilité des jeunes chercheurs, et experts en développant leurs compétences entrepreneuriales.
- **Valoriser** les travaux de jeunes chercheurs et experts dans les secteurs académique et industriel en augmentant leur visibilité au sein du réseau de l'IMAPS ACADEMY.

Nous travaillons sur la consolidation du consortium et la rédaction de la proposition qui devrait être soumise fin Avril 2018. Nous sommes convaincus que l'avenir d'IMAPS-France passe par ce type d'initiatives. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution du montage de ce projet et nous espérons pouvoir partager avec vous plus de détails sur le programme proposé à la prochaine Newsletter.

**Sanae BOULAY**

## Changement de domiciliation du Bureau IMAPS

17, rue de l'Amiral Hamelin  
PARIS 75783 Cedex 16

Métro : Iena (ligne 9), Boissière (ligne 6)

Bus : 32, 63, 82

Tél : 01 45 05 72 32

Pour tout renseignement complémentaire,  
contacter: Florence Vireton par messagerie : sur  
[imaps.france@imapsfrance.org](mailto:imaps.france@imapsfrance.org)

Visitez également notre nouveau site Internet :

[www.france.imapseurope.com](http://www.france.imapseurope.com)

***Prochaine édition : Janvier 2018***